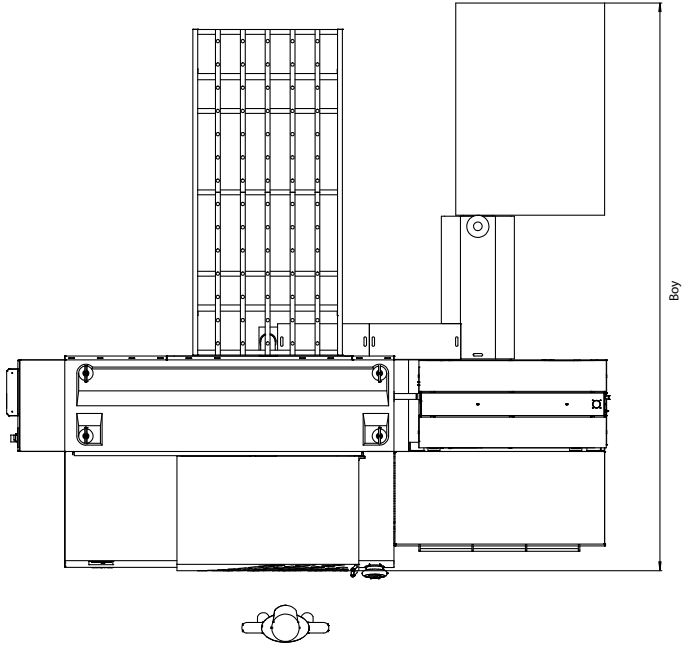
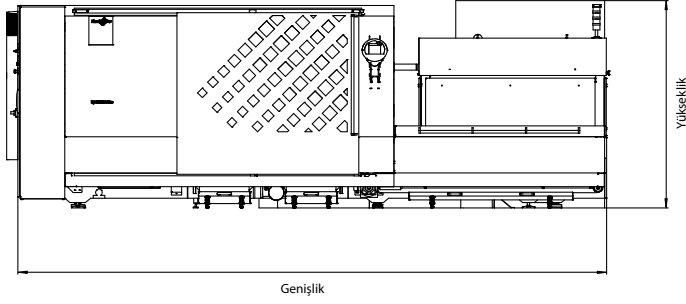


Teknik Özellikler

ByVention 3015

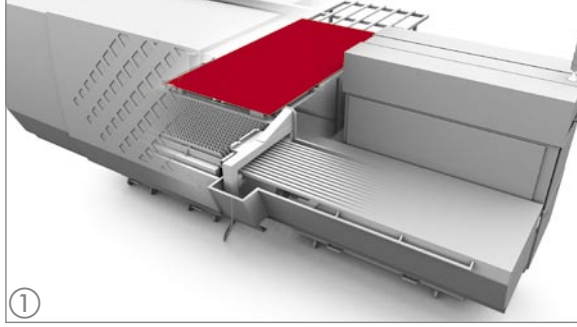


ByVention 3015

Lazer performansı	2200 W	4400 W
Boy	6000 mm	6000 mm
Genişlik	6000 mm	6400 mm
Yükseklik	2150 mm	2150 mm

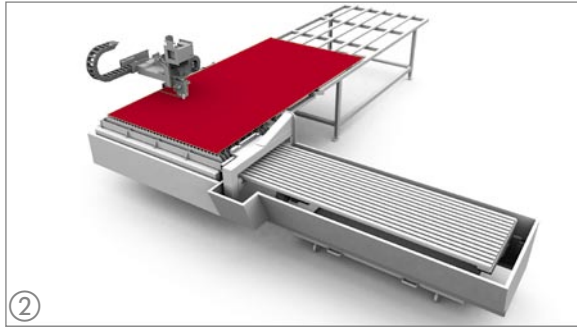
Yaratıcı malzeme akış konsepti

ByVention, standart ebatlı sacları kesebilen en küçük boyutlu lazer kesme tezgahıdır. Yaratıcı ve akıllı malzeme akış konsepti sayesinde işlenen parçalar otomatik ve kesintisiz olarak kesme alanının dışına alınabilir. Kesme prosesi devam ederken parçalar bir sonraki operasyona yollanabilir. İşlenmiş ürün masasına erişim çok kolay ve ergonomiktir. Çıkış bölgesine erişim kolaydır.



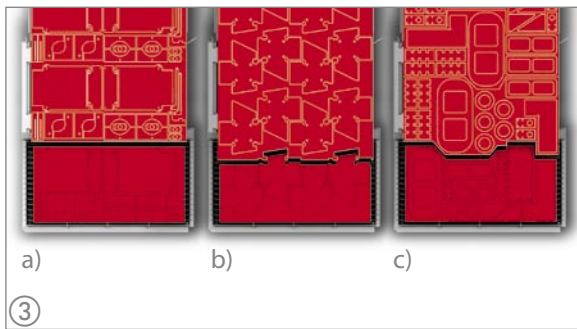
①

İşlenecek levha yükleme masasına manuel olarak yerleştirilir ve referans noktasına itilir.



②

Levha, kesme alanına otomatik olarak sürülür. İlk kesme alanı segmenti içindeki parçalar kesilir.



③

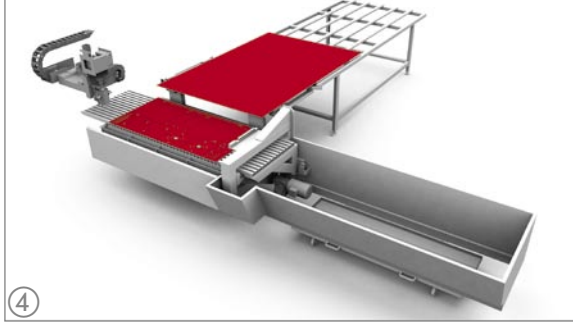
İşlenecek levha, birbiri ardınca sıralanan kesme alanları segmentlerine bölünür. Levha üzerinde nesting (yerleştirme) üç ayrı metodla yapılır.

a) Üst üste bindirmesiz strateji

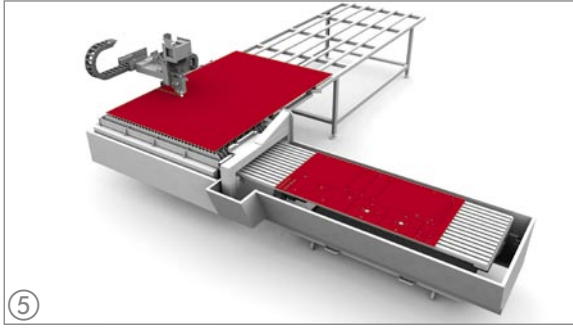
Dikdörtgen nesting konturu içine, minimum fire verecek şekilde, optimum yerleştirilebilen parçalar için uygundur. Alan içindeki parçaların kesim işleminden önce, kontur düz olarak kesilerek ana levhadan ayrılır. Kesme alanı segmentinin genişliği 772 mm'dir.

b) Üst üste bindirmeli ve kısmi kesim işlemli strateji

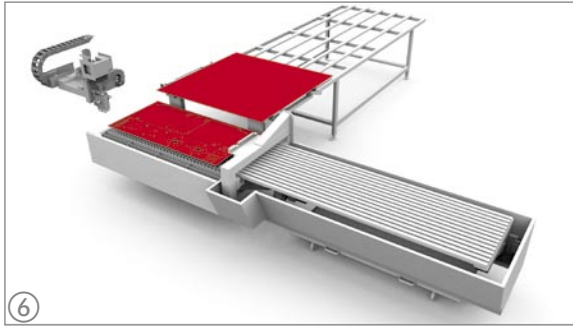
Dikdörtgen kontur içine, minimum fire verecek şekilde, optimum yerleşmesi mümkün olmayan parçalarda kullanılır. Kesme alanı konturunda yer alan parçaların geometrisi düz değildir, bu yüzden konturun düz bir kesimle ana plakadan ayrılması mümkün değildir. Kesme alanları segmentlerinin konturları birbirleri içine geçmek durumundadır. Herbir segment alanı segmentinde 772 mm genişlik ve 1562 mm boy içinde kalacak şekilde çalışılır.



Kesim işlemi biten segment otomatik olarak tahliye tablasına yerleştirilir.



Tahliye tablası, kesimi biten segmenti otomatik olarak kesme alanından alarak dışarıdaki işlenmiş ürün masasına taşır. Aynı anda, işlenmemiş levha otomatik olarak kesme alanına sürülerek bir sonraki segmentin kesim işlemine başlanır. İşlenmiş segment veya parçalar, işlenmiş ürün masasından manuel olarak alınır.



Kesim işlemi biten segment otomatik olarak tahliye tablasına yerleştirilir. Bu işlem tüm levha işlenene kadar tekrarlanır. İşlenmesi gereken son segment levha kesme alanına otomatik olarak sürüldükten hemen sonra, işlenecek yeni levha yükleme masasına yerleştirilebilir. Üretim kesintisiz olarak devam eder.

Bystronic kesme ve bükme yazılım programı Bysoft, ByVention kesme operasyonlarını optimum olarak destekler ve arzu edildiğinde programlama esnasında, levha üzerinde, en verimli segment stratejisinin otomatik olarak seçilmesini sağlar.

c) Üst üste bindirmeli ve tam kesim stratejisi

Bu strateji, strateji b)'ye alternatif olarak uygulanır, özellikle sac kalınlığı 3 mm'den başlayan, kompleks geometrik parçaların veya birçok parçanın üst üste bindiği alanlarda uygulanır. Strateji b)'nin aksine burada, parça profili boyunca belirli mesafede geçip giden yerde tam kesim olur. Bunun avantajı:

1. Bütün kalın saclarda zaman kazanmak için yalnızca bir kez sokulur
2. kompleks parçalarda da iç içe girmiş yüksek sac kalınlıkları gibi bir maksimum proses güvenliğini garanti eder.

Lazer performansı	2200 W	4400 W
Levha ebatları (boy x genişlik)	3000 x 1500 mm 2500 x 1250 mm 2000 x 1000 mm	3000 x 1500 mm 2500 x 1250 mm 2000 x 1000 mm
Kesme alanı	x = 1562 mm y = 772 mm z = 100 mm	x = 1562 mm y = 772 mm z = 100 mm
Maksimum pozisyonlama hızı-paralel akslarda x, y	100 m/dak	100 m/dak
Maksimum pozisyonlama hızı-bileşke akslarda	140 m/dak	140 m/dak
Pozisyonlama hassasiyeti Pa *	± 0.1 mm	± 0.1 mm
Tekrarlama hassasiyeti Ps *	± 0.05 mm	± 0.05 mm
Tezgah ağırlığı **	13 500 kg	14 600 kg
Zemin	normal, yerleşim planına uygun güçlendirilmiş endüstriyel zemin	
Kesme kafası 5"	dahil	dahil
Kesme kafası 7.5"	opsiyonel	dahil
Kesme gazı tüketimi	malzemeye göre değişir	
Panel vasıtasıyla operasyon	dokunmatik kontrol paneli	
Sürücüler	manuel kontrol ünitesi üzerinde USB 1.1 arabirim	
Network bağlantısı	RJ45 konektörü 10/100 MBit/s	
ByVision (Belirtilimler için bkz. ayrı veri sayfası)	opsiyonel	opsiyonel

CO ₂ rezonatör	ByLaser 2200	ByLaser 4400
Çıkış gücü	2200 W	4400 W
Dalga boyu	10.6 µm	10.6 µm
Polarizasyon	dairesel	dairesel
Darbe frekansı	1–2500 Hz	1–2500 Hz
Maksimum levha kalınlıkları ***		
Siyah çelik	8 mm	8 mm
Paslanmaz çelik	6 mm	8 mm
Alüminyum	4 mm	8 mm
Toplam sistemin maksimum elektrik tüketimi ****	35 kW	54 kW

* VDI/DGQ 3441'e göre 1 metre mesafedeki ölçüm. Parça hassasiyeti, levhanın malzeme kalitesine, levha üzerindeki termal etkiye, levhanın kesme operasyonundan önce maruz kaldığı taşıma şartlarına bağlıdır.

** Birleştirilmiş soğutma ve filtreleme ünitelerinin dışındaki toplam lazer kesme tezgahı

*** Maksimum kalınlıkların kesilebilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi şarttır:

- Sistemin uygun montajının ve düzenli bakımının yapılmış olması
- Bystronic tarafından tavsiye edilen malzeme kalitelerinin kullanılmış olması (lazer kesme kalitesine uygun malzemeler)

**** Soğutma ve filtreleme üniteleri dahil tüm sistemin maksimum güçte kullanılması halinde

Boyutlarda, konstrüksiyonda ve ekipmanda değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. ISO 9001 belgelidir